

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第3区分

【発行日】平成17年10月13日(2005.10.13)

【公開番号】特開2000-57292(P2000-57292A)

【公開日】平成12年2月25日(2000.2.25)

【出願番号】特願平10-227863

【国際特許分類第7版】

G 06 K 19/07

G 06 K 17/00

G 06 K 19/10

【F I】

G 06 K 19/00 H

G 06 K 17/00 S

G 06 K 19/00 R

【手続補正書】

【提出日】平成17年6月6日(2005.6.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0030

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0030】

【実施例3】

(1) 感圧性接着剤の調製

前記実施例1(1)で調製した感圧性接着剤を用いた。

(2) 非接触データキャリアラベルの調製

アクリル酸エチルエステル/メタクリル酸メチルエステル/アクリル酸ヒドロキシエチルエステルの共重合体(重量平均分子量=10万)からなる樹脂組成物100gに、塩化メチレン100gを加え、非接触データキャリアラベルの包埋用樹脂溶液とした。片側全表面をシリコーン樹脂により剥離処理したポリエチレンテレフタレートフィルム(縦=6cm, 横=9cm, 厚さ=50μm)上に、前記の樹脂溶液をドクターブレードによって塗布した。

この全面剥離処理フィルムに塗布された樹脂溶液に、非接触データキャリア要素(太さ20μmの銅からなるアンテナコイルにICチップの端子部を圧着させて製造)を埋没させた後、60の恒温槽に10分間投入して、乾燥させた。続いて、全面剥離処理フィルムをはがし、非接触データキャリア要素を包埋した樹脂層とした。この担体の厚さは20μmであった。

次に、基材フィルムであるポリエチレンテレフタレートフィルム(縦=6cm, 横=9cm, 厚さ=50μm)の片側表面上において、その一短辺側の端部から1cm内側の部分に、スクリーン印刷で直径1.8cmの円状にシリコーン樹脂を1μmの厚さで塗布し、140の恒温槽に1分間入れ、硬化させて剥離剤層を形成した。この上に、前記実施例1(1)で調製した感圧性接着剤溶液を、ドクターブレードによって塗布し、100の恒温槽に10分間投入し、乾燥させた。このフィルムに塗布された感圧性接着剤の厚さは20μmであった。

こうして得られたフィルムの前記接着剤面に、先に準備した非接触データキャリア要素を包埋した樹脂層を貼合して樹脂層貼合フィルムとした。この際、前記樹脂層に包埋されたICチップの部分が、基材フィルムに設けた剥離剤層の部分に重なるように位置を合わせた。

【手続補正2】**【補正対象書類名】**明細書**【補正対象項目名】**0035**【補正方法】**変更**【補正の内容】****【0035】**

一方、基材フィルムであるポリエチレンテレフタレートフィルム（縦 = 6 cm，横 = 9 cm，厚さ = 50 μ m）の片側表面上において、その一短辺側の端部から1 cm内側の部分に、スクリーン印刷で直径1.8 cmの円状にシリコーン樹脂を1 μ mの厚さで塗布し、140°の恒温槽に1分間入れ、硬化させて剥離剤層を形成した。このフィルムの剥離剤層を設けた面に、先に調製した接着剤含浸・非接触データキャリア回路包埋不織布積層体を貼合し、非接触データキャリアラベルを製造した。この際、基材フィルムに設けられた剥離剤層の部分とスリットとが重なるように位置を合わせた。この非接触データキャリアラベルについて、非接触送受信試験を行ったところ、正常に送受信を行うことを確認した。